

苏州东微半导体股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书

(苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区20幢515室)

保荐机构(主承销商)

(北京市朝阳区建国门外大街41号国贸大厦2座27层及28层)
二〇二二年二月九日

“第八节重要承诺事项”之“一、股份锁定的承诺”。

除上表披露的承诺情况外,本次发行后,公司部分核心技术人员作为高级管理人员和核心员工通过中金丰众40号资管计划持有本公司股份,上述战略配售集合资管计划持有本公司股份的限售期为12个月,限售期自本公司发行的股票在上交所上市之日起开始计算,具体情况详见本节“八、发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情况”。

截至本次公告书签署日,本公司尚未发行过债券,本公司核心技术人才不存在持有本公司债券的情况。

五、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排

(一)股权激励的基本情况

1.持股平台的股权激励情况

公司于2018年、2019年对部分核心员工实施了三次股权激励,公司部分核心员工通过持股平台苏州高维和得数聚才间接持有公司股份,截至本次公告书签署日,苏州高维和得数聚才分别持有公司3.3201%及2.1133%股权,具体情况如下:

(1)苏州高维

项目		基本情况
企业名称	苏州工业园区高维企业管理合伙企业(有限合伙)	
成立时间	2016年09月27日	
注册资本	223,960万元	
执行事务合伙人	王鹏飞	
经营范围	企业管理咨询、企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	

截至本次公告书签署日,苏州高维的合伙人职务及出资情况如下:

序号	合伙人姓名/名称	职务	出资额(万元)	出资比例(%)
1	王鹏飞	普通合伙人	111,040	49.604
2	刘钰	有限合伙人	10,000	4.464
3	刘伟	有限合伙人	32,502	14.522
4	魏志远	有限合伙人	27,963	12.480
5	林敏之	有限合伙人	5,320	2.378
6	钟晓东	有限合伙人	2,000	0.891
7	彭亦军	有限合伙人	1,038	0.462
8	魏伟	有限合伙人	1,038	0.462
9	陈伟	有限合伙人	0,708	0.316
10	徐海童	有限合伙人	0,530	0.237
11	梁建雄	有限合伙人	0,530	0.237
12	段超雄	有限合伙人	0,540	0.242
13	谢南	有限合伙人	0,540	0.242
14	刘冠南	有限合伙人	0,540	0.242

苏州高维不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情况,亦未聘请基金管理人行进行投资管理,不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金及私募基金管理人,因此不适用私募基金管理人登记及私募基金备案。

(2)得数聚才

项目		基本情况
企业名称	苏州工业园区得数聚才企业管理合伙企业(有限合伙)	
成立时间	2016年09月27日	
注册资本	142,394.0万元	
执行事务合伙人	王鹏飞	
经营范围	企业管理咨询、企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	

截至本次公告书签署日,得数聚才的合伙人职务及出资情况如下:

序号	合伙人姓名/名称	职务	出资额(万元)	出资比例(%)
1	魏伟	普通合伙人	31,138	21.820
2	苏州智盟私募基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	61,858	43.436
3	李强	有限合伙人	16,973	11.927
4	李健	有限合伙人	13,264	9.315
5	赵福海	有限合伙人	5,047	3.540
6	魏向东	有限合伙人	5,047	3.540
7	曹康林	有限合伙人	2,471	1.740
8	王睿	有限合伙人	2,030	1.426
9	刘明涛	有限合伙人	1,728	1.230
10	陈海军	有限合伙人	1,026	0.724
11	魏志远	有限合伙人	0,768	0.539
12	魏向东	有限合伙人	0,530	0.372
13	魏志远	有限合伙人	0,530	0.372
14	吴平	有限合伙人	0,540	0.382
15	魏向东	有限合伙人	0,282	0.199
16	魏向东	有限合伙人	0,282	0.199

得数聚才不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情况,亦未聘请基金管理人行进行投资管理,不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金及私募基金管理人,因此不适用私募基金管理人登记及私募基金备案。

三、其他股权激励情况

报告期内,除上述通过苏州高维和得数聚才两部分核心员工实施股权激励外,公司向卢松亦实施了股权激励。2016年12月4日,公司召开董事会会议,向卢松亦授予授予不超过相当本公司股本1.5%的股票。2018年12月21日,根据所附条件的实际情况及考核结果,卢广松符合各条件授予股权激励,王鹏飞与魏向东与卢广松签订《股权转让协议》和《股权转让补充协议》,约定将王鹏飞与魏向东持有的东微有限48.2%股权(对应21,329.27万股)和47.8%股权(对应21,152.2万股)分别以公允的价格转让给卢广松。同日,公司向开股东会,同意魏向东、王鹏飞与卢松亦上述股权转让事宜。

(二)减持承诺

具体内容请参见本次公告书“第八节 重要承诺事项”之“二、持股意向减持意向的承诺”。

(三)限售安排

持股平台苏州高维和得数聚才所持发行人的限售期限均为自本次公开发行的股票在上交所上市之日起36个月。

六、本次发行前后公司股本结构变动情况

本次发行前,公司总股本为950,532,276股,本次发行人民币普通股16,844,092股,占公开发行后总股本的25.03%,本次发行后公司的股本结构如下:

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)	
限售条件流通股					
王鹏飞	8,129,229	16.072	8,129,229	12.064	自上市之日起36个月
魏志远(SS)	7,672,500	15.184	7,672,500	11.387	自上市之日起36个月
魏向东	6,710,248	13.291	6,710,248	9.960	自上市之日起36个月
魏志远	5,028,573	9.912	5,028,573	7.464	自上市之日起36个月
中微国际(SS)	3,600,328	7.148	3,600,328	5.348	自上市之日起24个月(自限售股份之日起36个月)
瀚韵投资	3,290,762	6.124	3,290,762	4.948	自限售股份之日起36个月
中小企业发展基金	2,514,286	4.976	2,514,286	3.717	自上市之日起36个月
卢广松	2,286,460	4.726	2,398,460	3.540	自上市之日起36个月
苏州高维	2,236,960	4.428	2,236,960	3.201	自上市之日起36个月
智勇集团	1,511,243	2.996	1,511,243	2.240	自上市之日起36个月
魏向东	1,423,840	2.817	1,423,840	2.113	自上市之日起36个月
国策投资	1,141,972	2.269	1,141,972	1.694	自限售股份之日起36个月
王明涛	1,100,000	2.178	1,100,000	1.638	自上市之日起36个月
智勇集团	1,046,808	2.074	1,046,808	1.567	自限售股份之日起36个月
智勇集团	814,159	1.612	814,159	1.204	自上市之日起12个月
天智投资	694,412	1.374	694,412	1.006	自上市之日起12个月
王明涛	476,521	0.9416	476,521	0.702	自限售股份之日起36个月
王明涛	336,311	0.655	336,311	0.492	自上市之日起12个月
王明涛	283,209	0.546	283,209	0.420	自上市之日起12个月
上海爱登	96,164	0.183	96,164	0.141	自限售股份之日起36个月
中微国际(有限合伙)计划	-	-	506,322	0.750	自上市之日起24个月
中小企业发展基金	-	-	1,451,062	2.157	自上市之日起12个月
部分发行前限售股	-	-	638,514	0.947	自上市之日起0个月
限售条件流通股	-	-	-	-	-
本次发行后社会公众股	-	-	16,844,092	21.146	-
总股本	50,532,276	100.000	67,376,367	100.000	-

注1:根据《上市公司国有股权监督管理办法》的规定,国有股东的证券账户应标注“SS”。

注2:上表的持股比例合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,系为四舍五入所致。

七、本次发行后持股数量前十名股东

本次发行后,上市公司持股数量前十名股东的持股情况如下:

序号	股东	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限
1	王鹏飞	8,129,229	12.064	自上市之日起36个月
2	魏志远(SS)	7,672,500	11.387	自上市之日起36个月
3	魏向东	6,710,248	9.960	自上市之日起36个月
4	魏志远	5,028,573	7.464	自上市之日起36个月
5	瀚韵投资(SS)	3,600,328	5.348	自上市之日起24个月(自限售股份之日起36个月)
6	中微国际	3,290,762	4.948	自限售股份之日起36个月
7	中小企业发展基金	2,514,286	3.717	自上市之日起36个月
8	卢广松	2,398,460	3.540	自上市之日起36个月
9	苏州高维	2,236,960	3.201	自上市之日起36个月
10	智勇集团	1,511,243	2.240	自上市之日起36个月
合计	43,125,979	62.966	-	-

注1:根据《上市公司国有股权监督管理办法》的规定,国有股东的证券账户应标注“SS”。

注2:上表的持股比例合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,系为四舍五入所致。

八、发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情况

除上表披露的承诺情况外,本次发行后,公司部分高级管理人员和核心员工通过中金丰众40号资管计划持有本公司股份,上述战略配售集合资管计划持有本公司股份的限售期为12个月,限售期自本公司发行的股票在上交所上市之日起开始计算,具体情况详见本节“八、发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情况”。

截至本次公告书签署日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事及高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、核心技术人才培养情况

截至本次公告书签署日,公司核心技术人才的基本情况或直接或间接持有本公司股份的情况如下:

序号	姓名	职务	直接持股数量	间接持股数量
1	王鹏飞	董事兼首席执行官	8129229	111040
2	刘钰	研发总监	-	40000
3	刘伟	监事会主席兼首席研发工程师	-	32012
4	魏志远	首席研发工程师	-	50447

上表披露有关人员直接或间接所持发行人的股份的相关限售安排详见本次公告书之

股票简称:东微半导

股票代码:688261



特别提示

苏州东微半导体股份有限公司(以下简称“东微半导”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于2022年2月10日在上海证券交易所上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司信息披露信息的真实、准确、完整,承诺上述公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

二、上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

三、本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意投资风险,审慎决策,理性投资。

四、本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关事项,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

五、如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。本上市公告书中的报告期均指2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月。

六、投资者应注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性投资、谨慎决策。

七、具体而言,上市初期风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽
上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。

(二)科创板企业上市后的5个交易日后,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%,科创板股票存在股票价格波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

(三)流通股数量较少
上市初期,因原控股股东持有的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构限售股份锁定期为24个月,专项资产管理计划获配股票锁定期为12个月,网下限售股份锁定期为6个月,本次发行后本公司的无限售流通股为14,249,202股,占发行后总股本的21.16%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的
科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险。市场风险、保证金追缴风险和流动性风险、价格波动风险显著,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还需承担新增投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息,公开发行股票数量的比例为8.61%。

(五)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书的“第八节重要承诺事项”。

(六)发行前股东所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书的“第八节重要承诺事项”。

(七)中国证监会上市公司行业分类指引(2012年修订)中,公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”,截至2022年1月19日(T-3日),中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”最近一个月平均静态市盈率为49.01倍。

证券代码	证券简称	2020年年报EPS(元/股)	2020年年报EPS(元/股)	2020年年报EPS(元/股)	对应的静态市盈率(倍)	对应的静态市盈率(倍)
688111.SH	鼎新能	0.04	0.06	16326	166.77	171.20
600300.SH	华鲁恒升	0.04	0.03	8.81	247.50	252.98
688299.SH	华测检测	0.73	0.65	61.94	83.62	84.46
300372.SZ	德盛新材	0.74	0.72	63.69	88.27	90.07
600460.SH	士兰微	0.05	-	51.33	-	-
均值	-	0.51	0.59	-	146.79	160.88

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年1月19日(T-3)
注1:2020年年报EPS=EPS(扣非)/扣非:2019年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2020年1月19日)总股本

注2:士兰微2020年静态市盈率(扣非前)为数值,扣非后EPS和静态市盈率(扣非后)为负数,故不列示

注3:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成
本次发行价格130.00元/股对应的公司2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为42.930倍,高于中证指数有限公司发布的公司所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业公司静态市盈率平均水平,存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。公司和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

三、特别风险提示
(一)市场竞争风险
目前,我国的功率半导体行业正在快速发展阶段,随着我国消费电子、汽车电子、工业电子等多个行业的蓬勃发展以及智能装备制造、物联网、新能源等新兴产业的兴起,国内对功率半导体的需求迅速扩大,推动了行业的快速发展。良好的市场前景吸引了诸多国内企业进入这一领域,行业内厂商因自身优势不同积极投入进行市场竞争,市场竞争正在加剧。在日益激烈的市场竞争环境下,公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势,不能根据客户需求和进行技术创新,提高产品性能与服务品质,则公司的行业地位、市场份额、营收业绩等可能受到不利影响。

(二)高性能芯片及汽车相关应用的功率器件领域,公司目前在全球和国内市场占有率相对较低,市场主要份额仍被美国大厂占据。根据Omdia数据测算,2020年全球高压超级MOSFET的市场规模预计为9.42亿美元,公司市场份额为3.8%;2020年中国高压超级MOSFET市场规模预计为4.2亿美元,公司市场份额为9.8%。中低压MOSFET市场方面,2020年全球中低压MOSFET产品的市场规模为52.41亿美元,公司市场份额为0.2%;2020年度中国中低压MOSFET产品的市场规模为24.1亿美元,公司市场份额为0.4%。相比于消费电子、工业及汽车相关领域的客户对产品的性能和品质要求较高,验证周期普遍较长,如公司产品设计、工艺升级或客户资源开拓进度未达预期,将在与国外同行业的竞争中处于不利地位。例如,汽车领域客户对功率器件的性能、稳定性等具有很高的要求,产品验证周期较长,因此公司在该领域新的应用领域时可能会面临产品性能验证失败或产品性能不及竞争对手而无法获得订单的风险。若上述情况发生,将对发行人拓展新应用领域、提高市场占有率产生不利影响,进一步影响发行人的业绩表现。

(三)供应商集中度较高的风险
公司不直接从事晶圆制造和封装测试等生产和加工环节,报告期内,公司向前五名供应商采购内容主要为晶圆封装测试服务等,合计采购金额占当期采购总额的分别分别为99.56%、99.29%、99.01%及97.73%,其中向第一大供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为92.55%、89.72%、89.01%及72.85%。

报告期内,随着下游需求快速增长以及新冠疫情对全球晶圆代工行业产能带来的负面影响,晶圆代工行业出现产能紧张的情况,进一步导致了晶圆价格的增长。由于公司的晶圆供应商集中度较高,若晶圆代工行业产能紧张的情况进一步加剧,则晶圆代工产品的产能与供货可能无法满足发行人的需求,从而对公司的产品性能和未来收入增长造成一定不利影响。另一方面,公司成本主要由材料成本和封装费用构成,其中材料成本以晶圆成本为主,若晶圆价格未来持续提高,可能会对公司的主营业务成本以及毛利率水平造成不利影响。

(四)下游需求波动风险
报告期内,公司主营业务收入分别为15,283.52万元、19,604.66万元、30,878.74万元以及32,082.43万元,保持了持续快速增长;公司归属于母公司所有者的净利润分别为1,297.43万元、911.01万元、2,768.32万元以及4,180.53万元,亦保持了快速增长的趋势。公司主要产品包括高压超级结以及中低压薄膜MOSFET产品,广泛应用于充电桩、快充充电器、电机驱动、光伏逆变器等下游行业。报告期内公司业绩的持续增长主要系前述下游终端需求增长、进口替代等因素推动。为增强公司的技术优势及保持产品的竞争力,公司持续增加研发投入,扩大人员规模。但是,半导体行业具有较强的周期性特征,与宏观经济波动密切相关,如果宏观经济发生波动,可能会导致行业整体需求下降,公司将随之受到不利影响。因此,若新能源汽车、5G通信、光伏等驱动收入实现增长的下游行业发展不达预期,行业规模增速放缓或出现下滑,行业整体功率器件行业进口替代趋势放缓,公司的研发进展与成果不达预期,或宏观经济发展出现较大波动,则公司将面临业绩无法持续保持报告期内所实现的快速增长的风险。

此外,从产业链角度来看,由于下游终端产品结构相对复杂,产业链分工高度专业化,终端产品的推出往往需要整个产业链密切的合作才能完成,若未来产业链某个环节出现短缺的情形,终端产品的生产计划可能会出现阶段性停滞,或需要被迫推迟新产品的发布,以上可能会影响整体的采购需求,进而对包括公司在内的产业链公司造成不利影响。

(五)毛利率波动的风险
报告期内,公司的综合毛利率分别为26.38%、14.93%、17.85%及26.75%,波动较大。公司综合毛利率受产品品种、产品结构以及产品结构等因素影响。随着行业技术的发展和市场竞争的加剧,公司需要根据市场需求不断进行产品的迭代升级和创新,若公司未能正确判断下游需求变化,或公司技术实力停滞不前,或公司产品未能有效控制生产成本,或公司产品成本结构发生较大变化等导致成本上升和/或成本下降,均可能导致毛利率波动。在毛利率不利情况下,公司综合毛利率水平未来可能会持续波动甚至出现下降的情况,从而对公司的经营带来一定风险。此外,公司的产品规格数量较多,不同规格的产品销售结构的变化也会对公司的毛利率造成影响。

同时,考虑到第三代半导体材料功率器件可能是未来高性能功率器件的重要组成部分之一,若公司未来不能实现现有功率器件产品的进一步技术突破,或者研发出具有市场领先优势的第三代半导体材料功率器件,则公司的销售收入增长可能有所放缓,对公司的经营业绩造成不利影响。

同时,考虑到第三代半导体材料功率器件可能是未来高性能功率器件的重要组成部分之一,若公司未来不能实现现有功率器件产品的进一步技术突破,或者研发出具有市场领先优势的第三代半导体材料功率器件,则公司的销售收入增长可能有所放缓,对公司的经营业绩造成不利影响。

同时,考虑到第三代半导体材料功率器件可能是未来高性能功率器件的重要组成部分之一,若公司未来不能实现现有功率器件产品的进一步技术突破,或者研发出具有市场领先优势的第三代半导体材料功率器件,则公司的销售收入增长可能有所放缓,对公司的经营业绩造成不利影响。

同时,考虑到第三代半导体材料功率器件可能是未来高性能功率器件的重要组成部分之一,若公司未来不能实现现有功率器件产品的进一步技术突破,或者研发出具有市场领先优势的第三代半导体材料功率器件,则公司的销售收入增长可能有所放缓,对公司的经营业绩造成不利影响。

同时,考虑到第三代半导体材料功率器件可能是未来高性能功率器件的重要组成部分之一,若公司未来不能实现现有功率器件产品的进一步技术突破,或者研发出具有市场领先优势的第三代半导体材料功率器件,则公司的销售收入增长可能有所放缓,对公司的经营业绩造成不利影响。

同时,考虑到第三代半导体材料功率器件可能是未来高性能功率器件的重要组成部分之一,若公司未来不能实现现有功率器件产品的进一步技术突破,或者研发出具有市场领先优势的第三代半导体材料功率器件,则公司的销售收入增长可能有所放缓,对公司的经营业绩造成不利影响。

同时,考虑到第三代半导体材料功率器件可能是未来高性能功率器件的重要组成部分之一,若公司未来不能实现现有功率器件产品的进一步技术突破,或者研发出具有市场领先优势的第三代半导体材料功率器件,则公司的销售收入增长可能有所放缓,对公司的经营业绩造成不利影响。

同时,考虑到第三代半导体材料功率器件可能是未来高性能功率器件的重要组成部分之一,若公司未来不能实现现有功率器件产品的进一步技术突破,或者研发出具有市场领先优势的第三代半导体材料功率器件,则公司的销售收入增长可能有所放缓,对公司的经营业绩造成不利影响。

同时,考虑到第三代半导体材料功率器件可能是未来高性能功率器件的重要组成部分之一,若公司未来不能实现现有功率器件产品的进一步技术突破,或者研发出具有市场领先优势的第三代半导体材料功率器件,则公司的销售收入增长可能有所放缓,对公司的经营业绩造成不利影响。

同时,考虑到第三代半导体材料功率器件可能是未来高性能功率器件的重要组成部分之一,若公司未来不能实现现有功率器件产品的进一步技术突破,或者研发出具有市场领先优势的第三代半导体材料功率器件,则公司的销售收入增长可能有所放缓,对公司的经营业绩造成不利影响。

同时,考虑到第三代半导体材料功率器件可能是未来高性能功率器件的重要组成部分之一,若公司未来不能实现现有功率器件产品的进一步技术突破,或者研发出具有市场领先优势的第三代半导体材料功率器件,则公司的销售收入增长可能有所放缓,对公司的经营业绩造成不利影响。

同时,考虑到第三代半导体材料功率器件可能是未来高性能功率器件的重要组成部分之一,若公司未来不能实现现有功率器件产品的进一步技术突破,或者研发出具有市场领先优势的第三代半导体材料功率器件,则公司的销售收入增长可能有所放缓,对公司的经营业绩造成不利影响。

同时,考虑到第三代半导体材料功率器件可能是未来高性能功率器件的重要组成部分之一,若公司未来不能实现现有功率器件产品的进一步技术突破,或者研发出具有市场领先优势的第三代半导体材料功率器件,则公司的销售收入增长可能有所放缓,对公司的经营业绩造成不利影响。

同时,考虑到第三代半导体材料功率器件可能是未来高性能功率器件的重要组成部分之一,若公司未来不能实现现有功率器件产品的进一步技术突破,或者研发出具有市场领先优势的第三代半导体材料功率器件,则公司的销售收入增长可能有所放缓,对公司的经营业绩造成不利影响。

同时,考虑到第三代半导体材料功率器件可能是未来高性能功率器件的重要组成部分之一,若公司未来不能实现现有功率器件产品的进一步技术突破,或者研发出具有市场领先优势的第三代半导体材料功率器件,则公司的销售收入增长可能有所放缓,对公司的经营业绩造成不利影响。

同时,考虑到第三代半导体材料功率器件可能是未来高性能功率器件的重要组成部分之一,若公司未来不能实现现有功率器件产品的进一步技术突破,或者研发出具有市场领先优势的第三代半导体材料功率器件,则公司的销售收入增长可能有所放缓,对公司的经营业绩造成不利影响。

同时,考虑到第三代半导体材料功率器件可能是未来高性能功率器件的重要组成部分之一,若公司未来不能实现现有功率器件产品的进一步技术突破,或者研发出具有市场领先优势的第三代半导体材料功率器件,则公司的销售收入增长可能有所放缓,对公司的经营业绩造成不利影响。

同时,考虑到第三代半导体材料功率器件可能是未来高性能功率器件的重要组成部分之一,若公司未来不能实现现有功率器件产品的进一步技术突破,或者研发出具有市场领先优势的第三代半导体材料功率器件,则公司的销售收入增长可能有所放缓,对公司的经营业绩造成不利影响。

同时,考虑到第三代半导体材料功率器件可能是未来高性能功率器件的重要组成部分之一,若公司未来不能实现现有功率器件产品的进一步技术突破,或者研发出具有市场领先优势的第三代半导体材料功率器件,则公司的销售收入增长可能有所放缓,对公司的经营业绩造成不利影响。</